

高透明灌封胶电子硅胶 电路板元器件灌封防水密封 导热高绝缘耐温

产品名称	高透明灌封胶电子硅胶 电路板元器件灌封防水密封 导热高绝缘耐温
公司名称	惠州市固圣达新材料有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	品牌:达泽希 型号:6701 产地:广东省惠州市
公司地址	广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇德邦科技园3栋3楼
联系电话	18025302936

产品详情

一、产品特点

LT316HW-1是双组份有机硅加成体系导热灌封胶，有如下特点：

- 1、胶料在常温条件下混合后存放时间较长，但在加热条件下可快速固化，特别利于自动生产线上的使用。
- 2、耐高温性，耐高温老化性好。固化后在（ -60 ~ 250 ）温度范围内保持硅橡胶弹性，绝缘性能优异。
- 3、固化过程中不收缩，具有更优的防水、防潮和抗老化性能。
- 4、LT316HW-1 具有导热阻燃性，阻燃性能达到 UL94-V0 级。

二、典型用途

用于大功率电子元器件、对散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护。
如模块灌封，汽车 HID灯模块电源、汽车点火系统模块电源、太阳能板、变压器、传感器等。

三、使用工艺

1、按重量配比两组份放入混合罐内搅拌混合均匀。

2、将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内，一般可不抽真空脱泡，若需得到高导热性，建议真空脱泡后再灌注。室温或加热固化均可。胶的固化速度与固化温度有很大关系，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80℃下固化 10 - 20 分钟，室温条件下一般需 1小时左右固化。